

# 东芯半导体股份有限公司投资者关系活动记录表

## (2024年11月13日-11月14日)

证券代码：东芯股份

证券简称：688110

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（策略会）
参与单位名称	星元投资、德骏达隆资产、开源证券、必达资本、马斯达尔投资集团、Bank of America、Grand Alliance Asset Management、Pleiad Investment Advisors Limited、Neuberger Berman BD LLC、Boyu Capital Investment Management、盛钧投资
活动时间	2024年11月13日、11月14日
活动地点	公司会议室、策略会
上市公司接待人员姓名	董事、副总经理、董事会秘书：蒋雨舟 证券事务代表：黄沈幪 投资者关系：王佳颖
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司近期经营情况介绍 公司副总经理、董事会秘书蒋雨舟女士向与会投资者介绍了公司近期的经营情况。 二、交流的主要问题及答复 1、公司如何看待 IDM 模式和 Fabless 模式的区别？ 答：IDM 模式和 Fabless 模式各有优劣。IDM 模式的一大优势是可以自己把控供应量，可以调整产线布局。从成本方面来看，直接成本确实会有优势，但产线折旧会对财务报表有较大影响。另外，从资金角度，存在一次性巨大资本投入的压力。此外，产线的设计和运营角度也存在一定风险，如果制程方向或者某个技术环节没有达到很理想的状态，反而会带来更大的经营压力。Fabless 模式一方面可以避免初期巨大的资本投入，可以将资源集中在设计端。另一个优势是灵活，可以和不同的晶圆厂进行合作，通过前沿的设计技术在不同的厂家、不同的产线、不同的设备机台上面进行芯片测试，以寻求更佳良率和成本结构。

	<p>2、选择 wifi7 作为公司新的研发项目主要出于哪些考虑？</p> <p>答：公司看到 Wi-Fi 芯片市场广阔的空间，特别是 Wi-Fi 6/7 在高带宽、高安全性、低延时以及对多设备同时接入有较高要求的场景具备明显优势，未来将成为 Wi-Fi 芯片市场增长的主要驱动力，伴随着智能手机、笔记本电脑、物联网 (IoT) 设备、智能家电和其他联网设备的使用不断增加，推动了对 Wi-Fi 芯片组的需求，并增加了对可靠、快速无线通信的需求。物联网 (IoT) 的普及导致各种应用对 Wi-Fi 芯片组的需求增加，包括可穿戴技术、智能家电、工业自动化、医疗设备等。随着互联网连接在发展中国家的普及，对低成本 Wi-Fi 设备的需求增加，未来也将推动 Wi-Fi 芯片市场的增长。</p> <p>3、晶圆成本上公司是否有看到什么变化？</p> <p>答：随着产能挤兑情况的消除，预计下半年代工价格不会有太大变化，目前较为平稳。</p> <p>4、公司对于 NAND、DRAM、NOR、MCP 这几条产品线的定位？</p> <p>答：SLC NAND 方面，公司会保持在大陆市场的领先地位，不断增加产品料号，推进产品制程更迭，不断提升该产品线的市占率。NOR 产品方面公司积极推进中高容量产品的推出，努力提升市场份额。DRAM 方面公司会持续推出更多利基型 DRAM 产品，扩充产品料号。MCP 产品稳步发展，进行组合的迭代，从 4+4 的方案迭代到 8+8 甚至更高的方案并努力提高车规 MCP 的营收占比。</p> <p>5、公司看到 SLC NAND 目前的竞争格局如何？</p> <p>答：SLC NAND 作为较为细分市场的 2D NAND，目前三星已经正式宣布退出 SLC NAND 的市场，其他的国外大厂如美光、凯侠、西部数据、海力士等，我们判断也会逐步退出这个市场。一方面是因为本身这块业务占他们营收比重较低，另一方面他们会更关注于更大容量如 3D NAND 的产品市场。我们相信随着国外大厂的逐步退出，我们也有机会进一步提升我们在 SLC NAND 的市场份额。</p>
日期	2024 年 11 月 18 日